



新興ベンダ・ガイド・ツアー (C)

14:15-15:15

エーエスケイアシスト(ASKAssist)

秋山 俊恭

Electronic Design and Solution Fair 2010

Webにない“新しい”がここにある。
“New”@EDSFair, on-site. Not on web-site

EDSFair2010 新興ベンダーツアースケジュール(1月29日)

グループ	順番	会社名	本社所在地	URL	カテゴリ	特徴技術
第2回 ツアー (グループB)	1	POLYTEDA Software Corporation	カナダ	www.polyteda.com	インプリ	高速物理検証 高速かつ予測可能
	2	Micrologic Design Automation Inc.	米国	www.micrologic-da.com	インプリ	対話信頼性チェッカー 自動修正機能
	3	Dorado Design Automation, Inc.	米国	www.dorado-da.com	インプリ	タイミング考慮ECO セルベース、ゲートアレイ
	4	Teklatech	米国	www.teklatech.com	電力最適化	物理設計初期での 電源、IRドロップ解析
第3回 ツアー (グループC)	1	EDXACT	フランス	www.edxact.com	ミックスシグナル	大規模、高精度 寄生抽出、評価
	2	Concept Engineering GmbH	ドイツ	www.concept.de	フロントエンド ~ バックエンド	回路、ゲート、RTL可 視化、デバッグ環境
	3	Physware Inc.	米国	www.physware.com	SI/PI/EMI	高速電磁界解析 SI x10, EMI x100
	4	Interoperable PDK Alliance	米国	www.iplnow.com	アナログ	インターオペラブルPDK EDA 18 + TSMC

EDXACT



- **会社所在地**
 - グレノーブル(フランス)
- **会社概要**
 - EDXACTは、進んだ寄生の影響を解析する技術と回路シミュレーション性能を向上する技術を提供するリーディングカンパニー
 - 主なベンダーとのパートナーシップを実現
- **製品名**
 - Jivaro : 寄生のモデルベースの縮約
 - Comanche : 寄生素子探索、解析 (ESD, EM等)

EDXACT



- **製品の主な特徴**

- Jivaro

- 高精度なモデルベースの縮約、すべての種類の寄生を大量にかつ選択的に縮約。EMフローを含めて、ポストレイアウト解析をスピードアップ

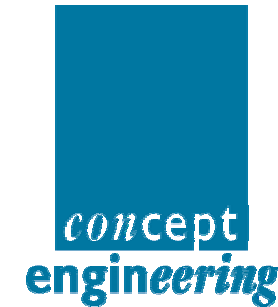
- Comanche

- ピン ピン抵抗、ディレイ、SYZパラメータ、クロスカップリング Cs、抵抗パス等を解析

- **主なメリット**

- 検証時間の短縮、生産性向上
- 検証品質向上、歩留向上

Concept Engineering GmbH



- **会社所在地**
 - フルバーグ(ドイツ)
- **会社概要**
 - Conceptのカスタマイズ容易なデバッグツールにより、設計者は、デザインをすばやく理解、デバッグ、最適化可能
- **製品名**
 - SpiceVision PRO
 - GateVision PRO
 - RTLvision PRO

Concept Engineering GmbH

- **製品の主な特徴**

- SpiceVision PRO
 - トランジスタレベルデバッグ (HSPICE, CDL, CALIBRE等)
- GateVision PRO
 - ゲートレベルデバッグ (Verilog, EDIF, LEF/DEF, SDF)
- RTLvision PRO
 - RTLレベルデバッグ (VHDL, Verilog, SystemVerilog)

- **主なメリット**

- プリ / ポストレイアウトのトランジスタレベルデバッグをサポート (SpiceVision PRO)
- 設計者のチップデザイン理解およびIPブロックの組み込み支援 (GateVision PRO, RTLvision PRO)

Physware Inc.

- **会社所在地**
 - ワシントン州ベルビュー (米国)
- **会社概要**
 - 革新的な高速3D電磁界解析ソリューションを提供しているリーディングカンパニー。ワイヤレス、メモリ、FPGA、マイクロプロセッサ、アナログ-RF用途において、チップパッケージボードの全体システムに対し、包括的な検証と設計が可能
- **製品名**
 - PhysWAVE
 - PhysAPEX
 - PhysBAND

Physware Inc.

- **製品の主な特徴**

- PhysWAVE

- 3DフルウェーブSI、PI、EMI解析

- PhysAPEX

- 3D高速パッケージ抽出

- PhysBAND

- システムレベルSSO、PI、SIの高速フルウェーブモデリング

- **主なメリット**

- 真の包括的パッケージ ボード解析ソリューション

- マックスウェルの精度を維持した高速境界要素法

- 10倍-100倍の高速化と処理能力

- 高速なりニアスケールリングアルゴリズムとマルチスレッド技術

Webにない“新しい”がここにある。
“New”@EDSFair, on-site, Not on web-site

Interoperable PDK Alliance

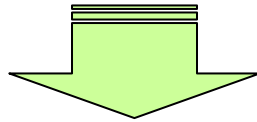
- **会社所在地(ベース拠点)**
 - カリフォルニア州マウンテンビュー(米国)
- **会社概要**
 - インターオペラブルなプロセスデザインキット(PDKs)とフローの標準化作成および推進を行うアライアンス組織
- **製品名**
 - Interoperable 90nm PDK reference circuit
 - Interoperable PyCells™ (Python PCells)
 - Interoperable Tcl call backs and iCDF standard

Interoperable PDK Alliance

- **製品の主な特徴**
 - インターオペラブルな OpenAccess™ベースのPDKs
 - TSMCにてiPDKに採用
 - 少量の記述量で、実行が早くかつ移植容易なPCells
 - パフォーマンス劣化のないAPI様式の相対オブジェクト設計(ROD)
- **主なメリット**
 - PDK開発およびサポートコスト削減
 - カスタムデザインフロー構築におけるツール選択肢拡大
 - デザイン再利用と移植性実現

お願い

- 日本は、開発においても魅力がなくなりつつある
 - 技術系の展示会等に海外からの参加者が減少
- 設計技術をリードしなければ、良い製品の開発が出来ない
 - 優秀な設計者を集めても、道具が整っていないければ、勝てない
- 日本で先端の開発を行い、他へ展開する時代は終わる



- 積極的に新しいEDA/設計技術を見て頂きたい
 - EDAベンダーの訪問は、受け入れ、議論する
 - EDAベンダーと技術的にもよい関係を作る
 - 商品マーケットと技術マーケット
- **大手ベンダーのブースだけでなく、中小ベンダーのブースに訪問し、議論して頂きたい**